



A Microchip Technology Company



2026年1月16日

SST社とUMC社、28nm SuperFlash® Gen 4 車載グレード 1 プラットフォームの 即時提供開始を発表

UMC社の28HPC+プロセスプラットフォーム上で車載グレード1の性能と信頼性を実現し、
マスクング工程数も大幅に削減するSST社の革新的なESF4

2026年1月16日[NASDAQ: MCHP] – 車載業界において高性能な車載コントローラへの要求が加速する中、Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫛晴彦 以下 Microchip 社)の子会社である Silicon Storage Technology® (SST 社)と、世界有数の半導体ファウンドリである United Microelectronics Corporation (NYSE UMC TWSE 2303)(以下 UMC 社)は本日、SST社のESF4(組み込み SuperFlash® Gen 4)がAG1(車載グレード1)に完全対応している事、およびUMC社の28HPC+ファウンドリ プロセス プラットフォームで量産を開始した事を発表しました。

SST社とUMC社の緊密な協力によって誕生したESF4は、eNVM(組み込み不揮発性メモリ)性能が強化されており、車載コントローラに求められる高い信頼性がある事が実証されています。また、他社ファウンドリの28nm HKMG (High-k メタルゲート)eFlash製品と比較して追加のマスクング工程数が大幅に少なく、コストと製造効率の両面で優位性があります。

現在、ファウンドリの40nm ESF3 AG1プラットフォームで車載コントローラ製品を製造中のお客様には、次世代プロセスノードへの移行に向けてUMC社の28nm ESF4 AG1プラットフォームの検討を推奨します。

Microchip社のライセンス ビジネス部門副社長の Mark Reiten は次のように述べています。「車載業界からの要求が加速する中、開発者は効率の向上、開発期間の短縮、厳しい業界標準への適合に対応できるソリューションを必要としています。UMC社とSST社はこうしたニーズに応え、堅牢な28nm AG1ソリューションを完成させました。既に、お客様の設計を即座に量産化できる状態が整っています。UMC社は、SST社およびSuperFlash革新における重要なパートナーであり、今後も両社は協力して急速に進化する市場要件に対応し、技術的にも経済的にも高度なソリューションを提供し続けます」

UMC社技術開発担当副社長の Steven Hsu氏は次のように述べています。「自動車業界がコネクテッド、自動運転、シェアリングへと急速に進化する中、信頼性の高いデータ ストレージと大容量データ更新への需要が高まり続けています。それに伴い、SuperFlashの28nmプロセスへの移行を求めるお客様の声が高まってきました。SST社との緊密な協力の下、ESF4ソリューションの提供を開始する事ができました。本ソリューションは、広く採用されている28HPC+プラットフォームに完全に統合されています。これにより、お客様は当社の豊富なモデルとIPを活用して主要市場に対応しつつ、より高度なプロセスノードへの移行も可能になります」

UMC社の28HPC+ ESF4 AG1プラットフォームにおけるSuperFlashの主な性能および信頼性指標:

- 動作温度-40~+150°C (Tj)でAEC-Q100グレード1認定済み
- 読み出しアクセス時間: 12.5 ns 未満



A Microchip Technology Company



- 書き換え回数: 10 万回以上
- データ保持期間: 125°Cで 10 年以上
- 必要な ECC: わずか 1 ビット
- 32 Mb マクロを用いた車載グレード 1 条件での認定:
 - ビット不良ゼロ(ECC 未適用)
 - ピーク歩留まり 100%達成

輸送業界では多様な車両アプリケーションに向けた革新的ソリューションへの需要が高まっており、車載コントローラの出荷量は年々急速に増加しています。この拡大する市場に効率的に対応するには、コントローラ内にコードとデータ格納用の高性能かつ高信頼性の eNVM を組み込む事が不可欠です。UMC 社の 28HPC+ AG1 プラットフォーム上の SST 社 ESF4 ソリューションは、OTA (Over-the-Air) アップデートに柔軟に対応できる大容量コントローラ ファームウェアを必要とするお客様のニーズにも応えます。

価格と在庫/供給状況

SST 社の SuperFlash 技術の詳細は [SST 社のウェブサイト](#) をご覧頂くか、[SST 社の各地域における販売担当者](#) にお問い合わせください。UMC 社の技術および製品の詳細は [UMC 社のウェブサイト](#) をご覧ください。

Microchip Technology 社について:

Microchip 社は、幅広い半導体製品を提供する半導体サプライヤであり、新しい技術を市場投入する際の重要な課題を解決するトータルシステム ソリューションを通じて、革新的な設計をより簡単に実現する事に尽力しています。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、コンセプトの創出から完成までの設計プロセス全体にわたってお客様をサポートします。Microchip 社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で優れた技術サポートとソリューションを提供しています。詳細は Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) をご覧ください。

SST 社(Silicon Storage Technology)について:

Microchip 社の子会社である SST 社は組み込みフラッシュ技術トップクラスのプロバイダです。SST 社は、特許技術である SuperFlash メモリテクノロジーの各種ソリューションを、コンシューマ、産業、車載、IoT (Internet of Things) 市場向けに開発、設計、ライセンス提供、販売しています。SST 社は 1989 年に設立され、1995 年に株式を公開し、2010 年 4 月に Microchip 社に買収されました。SST 社は現在 Microchip 社の完全子会社であり、カリフォルニア州サンノゼに本社があります。詳細は SST 社ウェブサイト (www.sst.com) をご覧ください。

Note: Microchip 社の名称とロゴ、Microchip ロゴ、Silicon Storage Technology、SST、SuperFlash は米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です。その他の商標は各社に帰属します。

UMC 社について:

UMC 社(NYSE UMC、TWSE 2303)は、世界をリードする半導体ファウンドリです。ロジックやスペシャルティテクノロジーを中心に、エレクトロニクス産業のあらゆる分野に向けて高品質な半導体の受託製造を行っています。UMC 社の包括的な技術および製造ソリューションには、ロジック/ミクストシグナル、組み込み高耐圧、組み込み不揮発性メモリ、RFSOI、BCD 等が含まれます。研究開発の中核的拠点と多くの 12 インチおよび



A Microchip Technology Company

UMC

8 インチ対応ファブは台湾にあり、アジア全域に合計 12 のファブを展開しています。12 インチウェハー換算で最大 40 万枚/月以上の製造能力を有し、全てのファブにおいて IATF 16949 認証(自動車)を取得しています。世界中に約 20,000 人の従業員を擁し、米国、欧州、中国、日本、韓国、シンガポールにオフィスを構えています。本社は台湾、新竹にあります。詳細は www.umc.com を参照してください。

将来予測に関する記述に関する UMC 社による注記

本発表に含まれる記述の一部は、米国連邦証券法における将来予測に関する記述に該当します。これには、新サービスや新技術の導入、将来のアウトソーシング、競争環境、ウェハー生産能力、事業提携関係、市場環境に関する記述が含まれます。投資家の皆様におかれましては、半導体市場および経済全体の動向、UMC 社製品に対する需要と市場受容性、技術および開発上のリスク等、様々な要因により、実際の事象や結果がこれらの記述と大きく異なる可能性がある事にご留意ください。これらのリスクおよびその他のリスクに関する詳細は、UMC 社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されています。UMC 社は、適用される法令で義務付けられる場合を除き、新たな情報、将来の出来事等の結果を受けて、将来予測に関する記述を更新する義務を負いません。

UMC 社報道関係者お問い合わせ先:

Michelle Yun

886-2-2658-9168 x16951

michelle_yun@umc.com